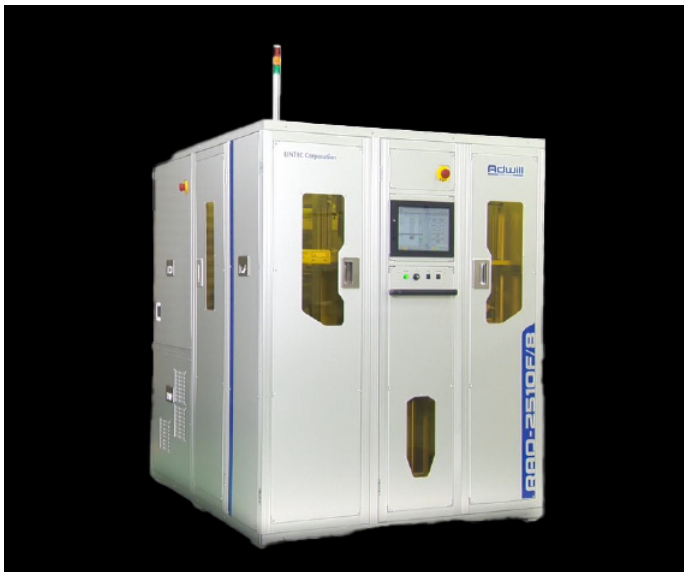
晶圆贴合机

RAD-2510F/8



概述

全自动晶圆贴片机，与薄型/翘曲的晶圆兼容。

通过优化传输机构从而实现高产能。

通过使用新型的切割胶带预切割系统，可以进一步减小胶带的间距，从而减少胶带损耗。

选配功能
- 双上料平台/下料平台
- 切割胶带预切割系统
- 贴膜台可加热
- 视觉系统 (晶圆ID读取器＆条形码打印,粘贴系统)
- 主机通信功能
  （通信方式：SECS-I、HSMS标准；软件：GEM标准）
- 防静电功能

适用的胶带
- 切割胶带: Adwill D系列, G系列
- 粘晶切割胶带: Adwill LE Tape
- 芯片背面保护胶带: Adwill LC Tape

规格

额定电源	供电电压	: AC200-230V ±10% (AC190-253V)
	频率	: 50/60Hz
	位相	: 单相
	功耗	: 1.5kW
气源	供气压力	: 0.6-0.8MPa
	耗气量	: <300L/分钟（ANR）
真空供给	真空压力	: <-80kPa

适用的晶圆尺寸 100mm、125mm、150mm、200mm

尺寸
机台宽度(W) : 1,360mm
设备纵深(D): 1,830mm
设备高度(H): 1,800mm
（凸出物及三色警示灯除外）

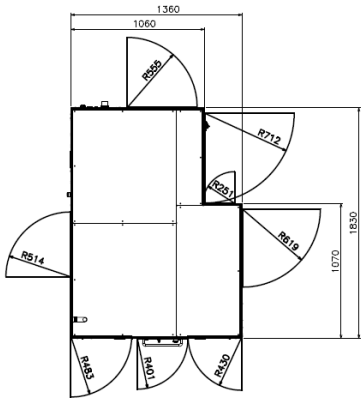
重量 1,500kg

UPH 120片/小时

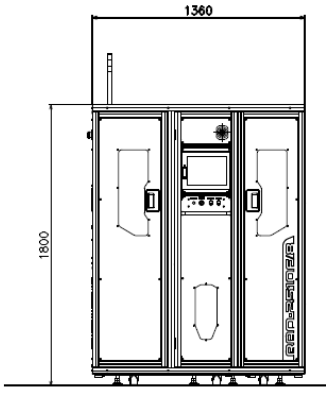
・上述处理能力依据的条件如下。
晶圆 : 200㎜镜面晶圆
切割胶带 : Adwill G系列 G-11

设备外形图

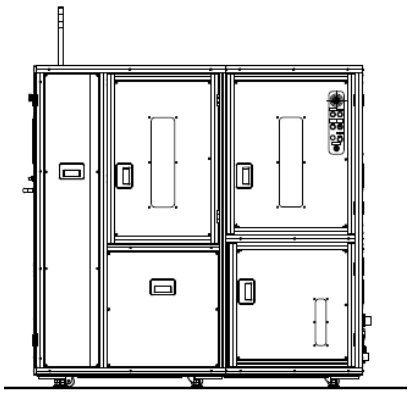
单位:mm



平面图



正面图



右侧面图

LINTEC Corporation *Linking your dreams*

Contact:Advanced Materials Operations

8th Fl., Bunkyo Garden Gate Tower, 1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002, Japan
TEL. +81-3-3868-7737 FAX. +81-3-3868-7726

●Head Office:23-23 Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-0001, Japan

https://www.adwill-global.com/cn